

Obsah

| | | |
|---|---|----|
| 1 | Úvod | 1 |
| 2 | Simulační program ANSYS Workbench | 2 |
| 3 | Popis testovacích vzorků | 3 |
| 4 | Postup experimentálního testování | 4 |
| 5 | Experimentální měření | 6 |
| | 5.1 Metodologie | 6 |
| | 5.1.1 Modální analýza | 6 |
| | 5.1.2 Testování metodou Step-stress | 7 |
| | 5.2 Jednovrstvé desky | 9 |
| | 5.3 Vícevrstvé desky | 9 |
| | 5.4 Desky propojené technologií BoB | 10 |
| | 5.5 Výsledky testu Step stress | 12 |
| 6 | Počítačové simulace | 13 |
| | 6.1 Popis modelu jednovrstvé desky | 13 |
| | 6.2 Popis modelu vícevrstvé desky | 14 |
| | 6.3 Desky technologie BoB | 16 |
| | 6.4 Propojení pomocí pinů | 16 |
| | 6.5 Vyšetření silikonové vrstvy | 17 |
| | 6.6 Vliv osazení komponenty | 18 |
| | 6.7 Simulace testovacích vzorků | 19 |
| | 6.8 Shrnutí | 20 |
| 7 | Závěr | 21 |